合金めっき技術の研究

アルミナセラミックスへの無電解ニッケルめっき

機械金属部 鈴木 宗明

1. 緒言

ニューセラミックスなど非電導性の新素材へ表面処理の要求は,ますます拡大しつつある。そこで本実験では,アルミナセラミックスへ無電解ニッケルめっきを施すことを目的に前処理条件の検討やめっき膜厚測定を行ったので報告する。

2. 実験方法

2.1 めっき液と試料

無電解ニッケルめっき液の組成を表1 に示す。 試料はアルミナセラミックス棒($100 \text{mm} \times 5 \phi$)を使用 した。(図1)

2.2 めっきの工程

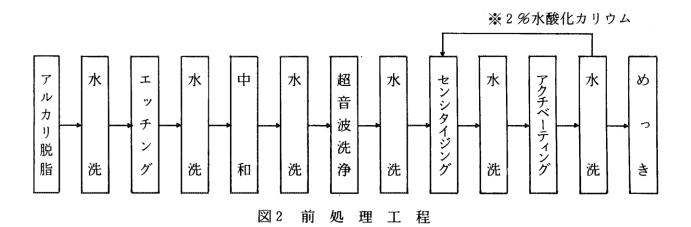
図2 にアルミナセラミックス棒へ均一なめっきを施 すための工程を示す。

表1 無電解ニッケルめっきの浴組成

薬品 種類	グリシン浴
硫 酸 ニ ッ ケ ル	30 g / l
次亜りん酸ナトリウム	20 g / l
クエン酸ナトリウム	20 g / l
グ リ シ ン	20 g / l
硝 酸 鉛	20 g / l



図1 アルミナセラミックス棒



2.3 めっきの条件

めっき槽は、1Lのビーカーにめっき液を建浴し、試料棒を1本吊り下げ、めっき条件を温度 $80\pm2^{\circ}$ C、pH 5 で60 分めっきを行った。(図3)

2.4 触媒化処理

触媒化処理は、セラミックス表面に無電解めっき反応を起こさせるのに必要な触媒となる金属(パラジウム、銀など)を均一に析出させる目的で行い、鋭敏化処理(センシタイジング)と

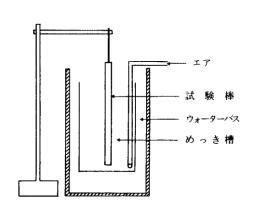


図3 めっき槽

活性化処理(アクチベーティング)の両方を含んでいる。また,均一な活性化面を得るために,鋭敏化処理と活性化処理を2回繰り返えした。

表 2 前処理工程における組成

エ・エング	触媒化	么 処 理
1 9 7 2 9	センシタイジング	アクチベーティング
10 %塩酸溶液	フッ化スズ 20g/l	塩化パラジウム0.3g/ℓ
温 度 50℃	塩酸 15 mℓ/ℓ	塩酸 10 mℓ/ℓ
浸漬時間 約2分	温 度 25℃	温 度 25℃
	浸漬時間 30分	浸漬時間 2分
	温 度 50℃	エッチング センシタイジング 10 %塩酸溶液 温度 50℃ 塩酸 15 mℓ/ℓ 浸漬時間 約 2 分 温度 25℃

2.5 めっき皮膜の厚さ測定

ニッケルめっき厚の測定は、ケイ光X 線微小部膜厚計(セイコー電子工業(株)、SFT157)を用い、1 試料片につき10 点測定し、その平均値をめっき厚とした。 (表3)

3. 実験結果及び考察

3.1 アルカリ脱脂工程における超音波洗浄

セラミックスの表面に付着している粉末 状の物を除去するためで,付着物を残留した ままめっきを行うと密着不良などの原因と なる。

3.2 エッチングと皮膜析出量の関係

エッチング(10%塩酸溶液浸漬)をしてもしなくても同じ程度の皮膜析出量は得られた。

表 3 ニッケルめっき厚み測定値

MEASUREMENT	RESULTS			
PARTS NAME:				
MEMO :				
Ni/Alumina				
1 Mi	10.10 +- 0.10	micron		
2 Ni	10.25 +- 0.10	micron		
3 Ni	10.15 +- 0.10	micron		
4 Ni	10.33 +- 0.10	micron		
5 Ni	9.91 +- 0.10	micron		
6 Ni	10.02 +- 0.10	micron		
7 Ni	10.12 +- 0.10	micron		
8 Ni	10.32 +- 0.10	micron		
9 Ni	9.93 +- 0.10	micron		
10 Ni	10.57 +- 0.10	micron		
Mi/Alumina	STATISTICAL	RESULT		
	Ni			
Data No:	10			
Maximum:	10.57			
Minimum:	9.91			
Range :	0.66			
	10.17			
	.0.20			
Kunit> micron				

4. 結 言

無電解ニッケルめっきがアルミナセラミックスなどの非電導素地上にも,均一な析出皮膜が得られた。今後の課題として,

- (1) めっき皮膜の密着強度の測定
- (2) めっき皮膜の耐食性試験などが考えられる。

参考文献

1)神戸ら:金属表面工業全書, 7

2)青谷 薫:金属表面工業全書, 5

3)神戸徳蔵:NP シリーズ無電解めっき

4)本間ら:金属表面技術誌, 33, 380 (1982)